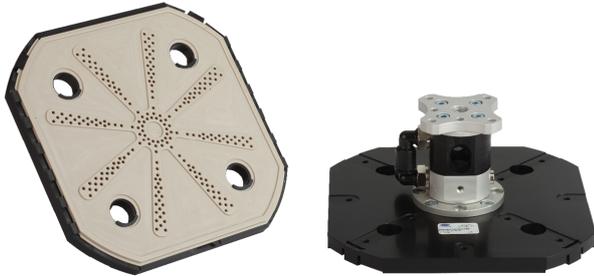


Pinze di presa per wafer SWGm Wet

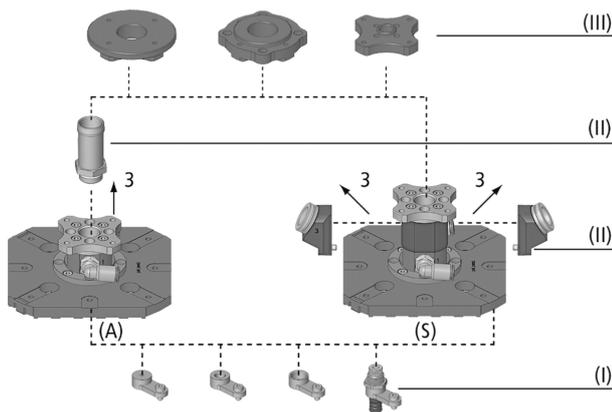
Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Pinza per wafer per una manipolazione estremamente veloce, affidabile, precisa e delicata dei wafer bagnati in applicazioni da banco bagnato
- Movimentazione di wafer dopo processi di trattamento con acido e di pulizia
- Processi di carico e scarico dal nastro trasportatore
- Produzione di celle solari in silicio interamente o parzialmente automatizzata con la massima stabilità di processo, tempo di attività della linea di produzione, efficienza delle celle e rendimento della linea



Pinze di presa per wafer SWGm Wet



Design del sistema Pinze di presa per wafer SWGm Wet

Design

- Modello base in versione con aria di scarico (3) assiale (A) o laterale (S)
- Geometrie della superficie di aspirazione selezionabili per misure celle comuni da 125 mm e 156 mm
- Componente opzionale per scarico controllato (II)
- Struttura modulare con accessori per il montaggio di sensori e modulo di aspirazione e smorzamento (I) e una selezione di moduli flangiati (III)
- Altezza di montaggio minima grazie alla struttura in plastica dal peso ridotto
- Superfici di contatto intercambiabili

Prodotti punti di forza del prodotto

- Punti di aspirazione appositamente posizionati e dimensionati consentono una manipolazione sicura delle cialde umide
- Manipolazione estremamente veloce e precisa grazie all'altezza e al peso ridotti
- L'alta capacità di aspirazione permette una presa sicura anche in caso di occupazione parziale o di perdite, ad esempio con cialde perforate
- Lo scarico controllato dell'aria aspirata previene la contaminazione dell'area di processo
- La funzione di sgancio rapido permette un posizionamento preciso dei wafer

Pinze di presa per wafer



Pinze di presa per wafer SWGm Wet

Dati di ordinazione Pinze di presa per wafer SWGm Wet

Tipo	N. articolo
SWGm-6S W 146x146x65 PEEK	10.01.30.00191
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK	10.01.30.00193